

非硅导热软质垫片 XK- PN50

简介：

在许多特殊应用中，硅胶的低分子硅氧挥发物是会造成光学与电学性质故障的，

XK-PN50 非硅导热软质垫片就是特别设计应用于这些对硅胶敏感元器件散热的。

XK-PN50 软质的非硅导热垫片兼具高绝缘性与高导热性，绝对是业界高效能材料。

特性：

无硅条件应用

电绝缘性

应用：

硬盘、光学通信



	unit	XK-PN50	Method
颜色 Color		Gray	visual
厚度 Thickness	mm	0.5~3.0	ASTM D374
密度 Specific Gravity	g/cm ³	3.2	ASTM D792
硬度 Hardness	Asker C	40	JIS K7312
	Shore 00	75	ASTM D2240
热阻抗 Thermal impedance@0.5mm	°Cin ² /W	0.15	ASTM D5470
导热系数 Thermal Conductivity	W/mK	5.0	HOT DISK
体积电阻 Volume Resistivity	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
击穿电压 Breakdown Voltage	KV/mm	>10	ASTM D149
介电常数 Dielectric Constant	1	8	ASTM D150
使用温度 Application temperature	°C	-40~125	
抗张强度 Tensile strength	psi	10	ASTM D149
伸长率 Elongation	%	20	ASTM D149
低硅氧挥发物 Siloxane Volatiles D4~D20	%	0	GC-FID
阻燃等级 Flammability	UL94	V-0	UL94